

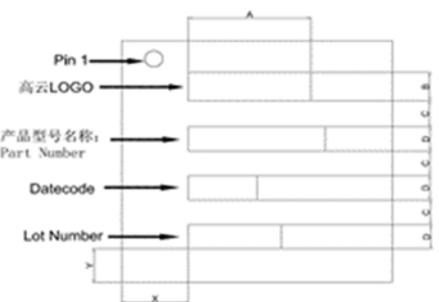
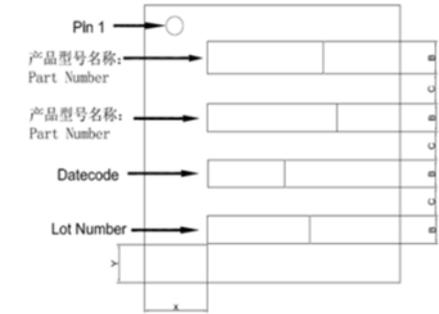
高云的产品变更通知 (GPCN)

概述

感谢您使用高云 FPGA 系列器件，此通知的目的是通知受此变更影响的客户注意此次变更，本次变更是为了规范产品丝印管理。

描述

统一尺寸为 23*23mm 以下的 QFN、BGA 封装产品的丝印内容。

变更前	<p>部分尺寸为 23*23mm 以下的 QFN、BGA 封装产品丝印如下(含高云 Logo):</p>  <p>The diagram shows a rectangular package with a grid of pins. A circle marks 'Pin 1' at the top-left corner. To its right is the 'Gowin LOGO'. Below the logo are three horizontal lines representing the 'Part Number', 'Datecode', and 'Lot Number' fields. Dimensions 'A' and 'X' are indicated at the top and bottom of the package.</p>
变更后	<p>统一尺寸 23*23mm 以下的 QFN、BGA 封装产品丝印如下(不含高云 Logo):</p>  <p>The diagram shows a similar rectangular package with a grid of pins. A circle marks 'Pin 1' at the top-left corner. Below it are three horizontal lines representing the 'Part Number', 'Datecode', and 'Lot Number' fields. The 'Gowin LOGO' is no longer present. Dimensions 'A' and 'X' are indicated at the top and bottom of the package.</p>

受影响的产品

部分尺寸为 23*23mm 以下的 QFN、BGA 封装产品。

关键日期

此次变更与 PCN 生效时间同步，自 2019 年 12 月 01 日开始执行，当前产品的 LTB 及 LTS 为 2019 年 11 月 30 日。

响应

请客户确认已收到此通知，如对此变更有任何问题或顾虑，请通知我们。如 30 日内没有响应，将默认已接受此变更。

附加文件

无

技术支持与反馈

广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网站：www.gowinsemi.com.cn

邮箱：support@gowinsemi.com

版本信息

日期	版本	说明
2019/06/01	1.0	初始版本。

版权所有©2019 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些档进行适时的更新。